# HP Multi Jet Fusion 1200 3D 列印機

## 快速起步，放眼未來。



以 HP MJF 1200 3D 列印機，為您的工作流程帶來工業級 3D 列印品質。

這款精巧的解決方案專為您的工作空間與預算設計，採用 HP 工業產品系列廣受信賴的 HP Multi Jet Fusion 技術，協助您製作堅固、精準的零件。

以 HP 積層製造生態系統為後盾，結合經實證的效能、簡易操作、可靠性與支援，讓您安心展開應用。

# 工業級品質，契合您的需求。



## 工業級品質，觸手可及

採用 HP 工業產品系列中經實證的 HP Multi Jet Fusion 技術，結合 10 年積層製造專業經驗，全球累計生產數億個零件(1)。

現在，這項技術以更容易入手(2)的系統提供，適用於更多工作空間與預算，為高要求應用提供一致、可靠的零件品質。

## 為實際應用而打造

製作堅固、精準且具水密性(2)的零件，適用於各種實際應用：從治具、夾具到工業、無人機、汽車及醫療保健等領域的最終用途零件；複雜幾何形狀也無需支撐結構。

## 從經實證的材料開始

從經實證的 HP 3D High Reusability PA 12 材料開始，由 Evonik 提供技術支援，滿足現今多元應用；未來亦規劃推出更多材料(4)。

# 操作簡易。彈性擴展。



## 簡化操作

自動上料、混料、取件及引導式工作流程，協助減少人工操作，讓從設計到成品的粉末式 3D 列印更加簡便。

## 安裝簡易

以精巧(2)、易於安裝的系統，將工業級 3D 列印帶入工作空間，順暢融入您的環境與工作流程。

## 為長期成長而生

從內部 HP Multi Jet Fusion 生產起步，隨需求成長擴充規模；需要額外產能時，HP 全球 MJF 零件供應商網絡將提供支援。

## 輕鬆切換材料

輕鬆切換材料並調整工作流程，隨需求演進探索並驗證新的應用。

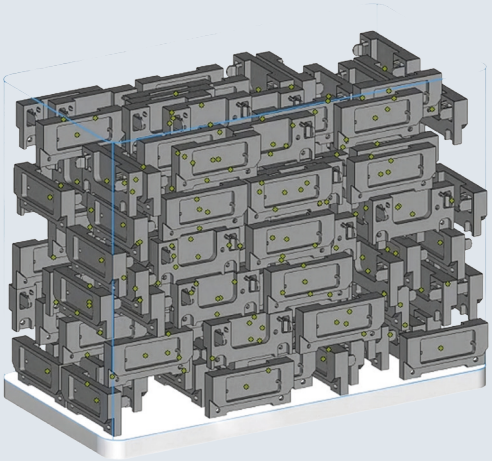
## 全程提供支援

遵循引導式工作流程，安心製作零件；從首次列印開始即有 HP 全球服務組織與經驗豐富的合作夥伴提供支援。

# 產出更多，掌握更多。

## 隔日取得所需數量的零件

依 HP MJF 製程設計，320 × 165 × 230 mm 的成形空間可在單次列印作業中有效容納多個零件，並支援隔日取得所需數量的零件(5)，減少對外包的依賴。



## 降低單件成本

透過內部生產、高重複使用率材料(6)及高效率工作流程改善零件經濟效益，減少材料浪費並使生產成本更可預期。

## 按產出付費，減少營運負擔

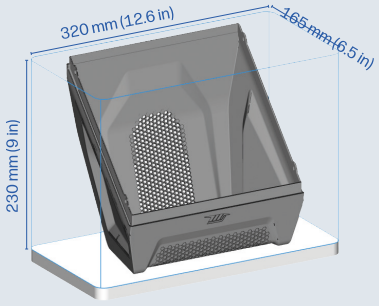
選用 HP 3D as a Service(7)，HP 負責補充材料，僅針對成功的成形作業收費，有助於簡化營運，讓成本與產量一致。

## 敏感設計由您掌控

透過內部生產，將敏感設計掌握在自己手中，減少開發與生產期間對外分享檔案的需要。

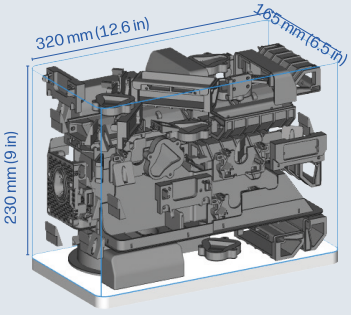
## 可預期的列印時間，穩定的生產效率

水平成形幾何配置與 HP MJF 的面式熔融製程，有助於在不同零件形狀、成形配置與裝填密度下，維持可預期的列印時間。



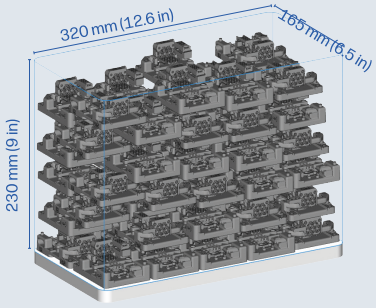

大型零件

列印時間約 12 小時




多樣零件混合

列印時間約 12 小時




重複批次

列印時間約 12 小時

## HP Multi Jet Fusion 1200 3D 列印機

| | | |
|---|---|---|
| 列印 | 技術 | HP Multi Jet Fusion 技術 |
| | 有效成形空間 | 320 × 165 × 230 mm<br>（12.6 × 6.5 × 9 in） |
| | 成形速度 | 1,206 $cm^3$/hr（73.6 $in^3$/hr） |
| | 層厚 | 0.10 mm（0.0039 in） |
| | 作業處理解析度（x,y） | 1200 dpi |
| | 列印解析度（x,y） | 1200 dpi |
| 尺寸<br>（寬×深×高） | 列印機 | 1725 × 710 × 1280 mm<br>（67.9 × 28.0 × 50.4 in） |
| | 運送 | 1854 × 765 × 1447 mm<br>（73.0 × 30.1 × 57.0 in） |
| | 操作空間 | 2037 × 1802 × 1800 mm<br>（80.2 × 70.9 × 70.9 in） |
| 重量 | 列印機 | 250 kg（551 lb） |
| | NCU | 5.4 kg（11.9 lb） |
| | NCU 運送 | 9.8 kg（21.6 lb） |
| | 運送 | 318 kg（701 lb） |
| 網路 | | Gigabit Ethernet（10/100/1000Base-T）；<br>支援 TCP/IP、DHCP（僅 IPv4）、TLS/SSL |
| 處理器<br>及記憶體 | 處理器 | 第 13 代 Intel(R) Core(TM) i3（13100E，最高 4.2GHz） |
| | 記憶體 | 24 GB |
| 硬碟 | | 250 GB |
| 軟體 | 相容軟體 | HP 3D Command Center<br>HP 3D Center<br>HP 3D API<br>Magics Print for HP |
| | 支援檔案格式 | 3MF, STL, OBJ, IGES |
| 電源 | 耗電量 | 峰值：6 kW；平均：3.5 kW |
| | 電源需求 | 2 組單相 200–240V，16A，50–60Hz |
| 保固 | | 一年有限硬體保固 |

瞭解 HP Multi Jet Fusion 3D 列印機：
hp.com/MJF1200

聯絡 HP 3D 列印代表：

## HP Multi Jet Fusion 1200 3D 材料管理系統（MMS）

| | | |
|---|---|---|
| 功能 | | 自動上料、混料及取件 |
| 尺寸<br>（寬×深×高） | MMS | 1140 × 640 × 1590 mm（含罩）<br>（44.9 × 25.2 × 62.6 in） |
| | 運送 | 1230 × 770 × 1200 mm<br>（48.4 × 30.3 × 47.2 in） |
| | 操作空間 | 1930 × 1750 × 1600 mm<br>（76.0 × 68.9 × 63.0 in） |
| 重量 | 處理站 | 132 kg（291 lb） |
| | 運送 | 193 kg（426 lb） |
| 電源 | 耗電量 | 峰值：350W；平均：100W |
| | 電源需求 | 1 組單相 200–240V，4A，50–60Hz |
| 保固 | | 一年有限硬體保固 |
| 環境規格 | 操作溫度 | 20–30°C（68–86°F） |
| | 儲存溫度 | -25 至 55°C（-13 至 131°F） |
| | 操作濕度 | 40–80%（無冷凝） |
| | 儲存濕度 | < 90%（無冷凝） |

## 訂購資訊

| | 產品編號 | 產品 |
|---|---|---|
| 硬體 | B03DJA | HP Multi Jet Fusion 1200 3D 列印機 |
| | B03DGA | HP Multi Jet Fusion 1200 3D 自然冷卻裝置 |
| 配件 | B03DHA | HP Multi Jet Fusion 1200 3D 材料管理系統 |
| | BD3D3A | HP Multi Jet Fusion 1200 3D 材料桶 |
| | E25TQA | HP Multi Jet Fusion 1200 3D 材料回收裝置 |
| 材料 | CT8E6A | HP 3D High Reusability PA 12，Evonik 技術材料（10 kg） |
| 耗材 | B59LXA | HP 3D 800 1L 熔融劑 |
| | B59LYA | HP 3D 800 1L 細化劑 |
| | B59LWA | HP 3D 1200 列印頭 |
| | B5RJ2A | HP 3D 1200 清潔滾筒 |

1. 根據 HP 內部報告，截至 2026 年 6 月，全球使用 HP Multi Jet Fusion 技術生產的零件累計數量。
2. 根據截至 2026 年 5 月現有 HP 工業 MJF 列印機的總佔地面積與系統價格比較。
3. 水密性可能因壁厚或幾何形狀而異；實際結果因應用而異。
4. 未來材料相關資訊反映 HP 目前規劃，可能隨時變更，恕不另行通知。時程、規格、相容性及供應情況可能因國家而異，且不予保證。
5. 隔日供件以使用 HP 3D High Reusability PA 12、標準列印模式且符合條件的列印作業為依據。列印、冷卻、取件、清潔及後處理時間會因成形高度、零件幾何形狀、裝填密度、材料、列印模式、工作流程與應用需求而異。
6. 根據 HP 持續進行的內部測試。使用 HP 3D High Reusability 材料的 HP Jet Fusion 3D 列印，粉末重複使用率最高可達 90%。材料在工業平台列印條件下老化，並按世代追蹤粉末，以反映最嚴苛的重複使用情境；各世代零件均接受機械性能及尺寸精度測試。
7. HP 3D as a Service 的供應情況、價格、所含耗材與服務、計費條件、自動補充及客戶成功支援，因國家、合約、系統配置與使用情況而異。費用須遵守適用的計費成形作業定義及 HP 3DaaS 服務條款。

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P.
HP 產品與服務的保固，僅以隨附之明示保固聲明為準。本文件任何內容均不應解釋為構成額外保固。HP 不對本文件中的技術或編輯錯誤或遺漏負責。
2026 年 10 月